■論文分野とキーワード

	分類		キーワード									
	大分類	小分類										
1	材料技術	樹脂・有機材料	樹脂 接着剤	低誘電率材料 レジスト	誘電性ポリマー フィルム	熱硬化性樹脂 インク	熱可塑性樹脂 導電性ペースト	感光性樹脂 ｴﾎﾟｷｼ・ｴﾎﾟｷｼﾚｼﾞﾝ	導電性高分子 ポリイミド	液晶 銅張積層板	封止材料 光ファイバ導波路	接合材料
		ガラス・セラミック材料	半導体 無機フィラー	磁性体 ペースト	圧電材料 保護膜	高誘電率材料 光ファイバ	低誘電率材料 層間絶縁膜	コンデンサ材料 複合基板	導電性セラミックス Pbフリー	結晶化ガラス	ガラス繊維	ガラスクロス
		金属材料	配線材料 金属微粒子	抵抗材料 メタルベース基板	磁性体 銅張基板	電極材料 ペースト	はんだ めっき	鉛フリーはんだ 腐食	リードフレーム材料 触媒	金属箔	銅箔	導電性フィラー
2	回路・実装設計 ／電磁特性技術	回路・実装設計技術	CAD 3次元実装設計	配線板パターン設計 実装ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術	回路ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術 ｼｸﾞﾅﾙ・ｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ設計	接続実装設計 ﾊﾟﾜｰ・ｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ設計	放熱実装設計 平衡伝送／不平衡伝送	半導体パッケージ設計 EMC実装設計	デジタル回路設計 高速高周波実装設計	検査実装設計	CAE	ﾁｯﾌﾟ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾎﾞｰﾄﾞ協調設計
		電磁特性技術	高速・高周波伝送線路 EMCｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 無線電力伝送	高速・高周波特性ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ EMCモデリング	高速・高周波特性測定・評価 エミッション	高速・高周波部品・材料 ｻｾﾌﾟﾀﾋﾞﾘﾃｨ	高速・高周波用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｲﾐｭﾆﾃｨ	高速・高周波デバイス ESD(Electrostatic Discharge)	無線ﾓｼﾞｭｰﾙ	EMC測定評価 EMC用部品・材料	メタマテリアル 高周波材料測定・評価	アンテナ実装 EMI
3	特性解析・評価技術	機械強度、構造、 応力解析評価技術	変形 靭性 ヤング率	応力 き裂 ポアソン比	疲労 クリープ	ひずみ 破断	そり せん断	ねじれ 有限要素法	応力解析 熱膨張係数	脆性破壊 膨張率	延性破壊 ｺﾌｨﾝ・ﾏﾝｿﾝの式	弾性 寿命
4	回路形成 ・配線板製造技術	めっき・エッチング 回路形成	パターン形成 露光・現像	成膜プロセス	真空成膜技術	メタライズ	アディティブ	サブトラクティブ	めっき	エッチング	表面処理	洗浄・前処理
		有機材料プロセス	多層配線板構造及びﾌﾟﾛｾｽ 穴あけ	多層化技術 デスミア	層間接続技術 アートワーク	ビルドアップ レジスト	積層接着 各種マスク形成技術（ﾚｼﾞｽﾄ・ﾌｫﾄﾏｽｸ等）	ラミネート	樹脂硬化 モールド	印刷	塗布	研磨
		無機材料プロセス	多層配線板構造及びﾌﾟﾛｾｽ ドクターブレード	多層化技術 ミリング	層間接続技術 ガラスセラミック	焼結・焼成技術 穴あけ	印刷	セラミック	ガラス	ゾルゲル	ペースト	バインダ
		配線板及び製造技術一般	リジッド配線板	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ配線板	ﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ配線板	複合配線板	ｲﾝﾀｰﾎﾟｰｻﾞ/ｻﾌﾞｽﾄﾚｰﾄ	HTCC/LTCC	ﾒﾀﾙﾍﾞｰｽ/ﾒﾀﾙｺｱ	MID基板技術		
5	信頼性解析技術	機械強度・構造信頼性	延性 熱応力/ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ	疲労 膜応力	破壊 応力設計	き裂 熱応力設計	機械衝撃 熱解析	振動衝撃 クリープ	強度	靭性	応力解析/ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ	寿命
		絶縁信頼性	短絡 ウィスカ	絶縁	マイグレーション	デンドライト	CAF	絶縁抵抗	耐電圧	耐湿性	寿命	電気的寿命評価/ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
		接続信頼性	実装材料 クリープ	はんだ	金属間化合物	接合	拡散	疲労	応力	接触抵抗	接続抵抗	寿命
6	電子回路部品実装技術	電子部品技術	電子部品 薄膜素子	モジュール コンデンサ	高周波部品 抵抗	集積・複合部品 コイル	チップ部品 マイクロマシン	ビルドアップ配線板 フィルムキャリア	部品内蔵配線板	FPC	積層	厚膜素子
		接合・接続技術	表面実装 COF	インターコネクション ゼブラゴム	ダイボンド	フリップチップ	ワイヤボンディング	TAB	COB	COC	COG	COW
7	検査および装置技術		積層厚さ検査 実装板外観検査	穴形成・検査 実装板電気検査	めっき その他の検査	露光	配線板外観検査	配線板電気検査	内部検査	表面処理・検査	エッチング	パターン形成・検査
8	光回路実装技術		光実装	光表面実装	光インタコネクション	光I/O	光モジュール	光部品	光集積	光ファイバー	光回路	光導波路
9	環境調和型実装技術		廃棄物 資源保護	リサイクル プロセス改善	VOC 代替物質	鉛フリー 化学物質管理	ハロゲンフリー 環境分析・解析	省エネルギ 環境対応	効率改善 再生可能エネルギ	長寿命化	熱管理	資源削減
10	半導体パッケージ・ モジュール技術	パッケージ	SOP/SOJ 樹脂	QFP めっき	BGA/CSP 封止（モールド）	ワイヤボンディング 信頼性／解析	TAB 設計	リードフレーム	インタポーザ	ウエハレベル	フリップチップ	バンプ
		ﾓｼﾞｭｰﾙ技術・SIP技術	MCM	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞIC	３次元構造	スタック	信頼性／解析	設計				
11	マイクロメカトロニクス実装技術(MEMS)		MEMS実装 三次元加工	MEMS-CMOS集積化 ユビキタスシステム	光MEMS実装 センサネットワーク	流体MEMS実装 ウエアラブルデバイス	ﾏｲｸﾛｴﾈﾙｷﾞ源 マイクロシステム融合	エネルギーハーベスト ヘテロ集積化	ウエハボンディング	マイクロマシニング	ナノインプリント	微細部品成型
12	部品内蔵技術		ウエハレベルパッケージ	ビルドアップ	ガラスエポキシ基板	ベアチップ	薄型化	高機能モジュール	モバイル機器	三次元実装	IC内蔵	配線層
13	プリンタブルデバイス実装技術		フレキシブル	ナノインク	電子ペーパー	ﾗｰｼﾞｴﾘｱﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ	カーボンナノチューブ	金属ナノワイヤ	グラビア	転写印刷	フレキソ印刷	インクジェット
14	サーマルマネジメント技術		冷却技術 熱抵抗 定積比熱	放熱技術 熱物性 黒体	熱伝導 ﾏｲｸﾛﾅﾉｽｹｰﾙ熱輸送 熱暴走	熱伝導率 データセンター 過度温度上昇	対流 相変化 ﾁｯﾌﾟｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度	放射 温度予測 熱回路網法	ファン 温度計測 ペルチェ効果	ヒートシンク ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ｽﾃﾌｧﾝ・ﾎﾞﾙﾂﾏﾝ定数	ヒートパイプ フィン	TIM 熱容量
15	パワーエレクトロニクス		検討中									
16	カーエレクトロニクス		検討中									
17	ヘルスケアデバイス実装技術		検討中									